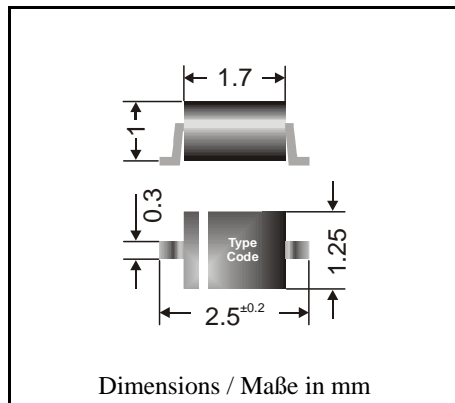


Surface mount Small Signal Diodes Kleinsignal-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2004-04-09



Power dissipation – Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	120...250 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOD-323
Weight approx. – Gewicht ca.	0.005 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings (T_A = 25°C)**Grenzwerte (T_A = 25°C)**

		BAV19WS, BAV20WS, BAV21WS	
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	200 mW ¹⁾
Max. average forward current (dc) Dauergrenzstrom		I _{FAV}	200 mA ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom		I _{FRM}	625 mA ¹⁾
Peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 s t _p ≤ 1 μs	I _{FSM} I _{FSM}	1 A 2.5 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	BAV19WS BAV20WS BAV21WS	V _{RRM} V _{RRM} V _{RRM}	120 V 200 V 250 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _s	- 55...+ 150°C

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

Forward voltage ²⁾ Durchlaßspannung		I _F = 100 mA I _F = 200 mA	V _F V _F	< 1 V < 1.25 V	
Leakage current ²⁾ Sperrstrom	T _j = 25°C	BAV19WS BAV20WS BAV21WS	V _R = 100 V V _R = 150 V V _R = 200 V	I _R	< 100 nA
	T _j = 150°C	BAV19WS BAV20WS BAV21WS	V _R = 100 V V _R = 150 V V _R = 200 V	I _R	< 15 μA

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal

Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

Continuous reverse voltage Sperrspannung	BAV19WS BAV20WS BAV21WS	V_R V_R V_R	100 V 150 V 200 V
Max. junction Capacitance – Max. Sperrschichtkapazität $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		C_T	1.5 pF
Reverse recovery time - Sperrverzug $I_F = 30\text{ mA}$ über / through $I_R = 30\text{ mA}$ bis / to $I_R = 3\text{ mA}$		t_{rr}	< 50 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	625 K/W ¹⁾
Marking - Stempelung	BAV19WS BAV20WS BAV21WS		A8 A9 or / oder T2 AA or / oder T3

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß